

展示会出展のご案内

第 29 回ものづくりワールド大阪 ～ものづくり NEXT～

2026 年 10 月 7 日(水)～9 日(金)にインテックス大阪（3 号館）にて開催される、『第 29 回ものづくりワールド大阪 ～ものづくり NEXT～』に出展することをお知らせいたします。
ご来場の際は、ぜひテクノホライゾン株式会社出展ブースにお立ち寄りください。

【ブースの見どころ】

当社ブースでは、「フィジカル AI／エッジ AI」をテーマに、AI モデルと自社開発のハードウェア・制御技術を組み合わせた実機デモンストレーションを行います。画像認識による自動追従、Jetson AGX Orin 上で動作する VLM（視覚言語モデル）、自社製 AI-BOX を用いた物体検出・追跡をご紹介します。ハードウェア開発から AI アルゴリズムの実装まで、お客様の用途に応じた受託開発に対応します。

【出展製品】

■ 画像認識による追従デモ

可動ノズル先端のカメラで顔や色を認識し、対象物を追従します。画像認識とモーター制御を組み合わせた技術をご覧ください。

■ エッジデバイスで動く LLM・VLM

Web カメラの映像と入力した指示をもとに、AI が映像の内容をリアルタイムで解析し、回答します。NVIDIA のエッジデバイス「Jetson AGX Orin」上で VLM（視覚言語モデル）を動作させ、AI を製品へ組み込む技術をご紹介します。

■ 自社製 AI-BOX を用いたエッジ AI デモ

NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB モジュールを搭載した自社製 AI-BOX により、Web カメラに映る人物や物体を、テキストで指定して検出・追跡します。Meta 製「SAM3」を活用し、ハードウェア開発からビジョン AI 開発まで対応できる当社の技術をご紹介します。

【社名変更のお知らせ】

2027 年 1 月 1 日、テクノホライゾン株式会社は、ELMO 株式会社になります。
各事業が磨いてきた光を、ひとつの大きな力へと束ねます。その新たな旗印が、ELMO です。
本展のブースでは、新しいロゴを掲げてお迎えします。

【展示会概要】

展 示 会 名	第 29 回ものづくりワールド大阪 ～ものづくり NEXT～ (HP : https://www.manufacturing-world.jp/hub/ja-jp/about/next.html)
会 期	2026 年 10 月 7 日 (水) ～10 月 9 日 (金) 10:00～17:00
会 場	インテックス大阪 (3 号館) ブース No. 20-22 ※交通アクセスは HP をご覧ください。
主 催	RX Japan 株式会社

ご入場には来場事前登録が必要です。[こちらから](#)来場事前登録の手続きが可能です。



お 問 合 せ 先	テクノホライゾン株式会社 映像&IT ビジネス営業部／ロボティクス営業本部 elmo-info.mw@th-grp.jp
-----------	--

- 本書に記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。